

<b>Erklärung zu California's Proposition 65</b>	<b>Statement on California's Proposition 65</b>
Datum 05.03.2025	Date: Mar 05, 2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

Mit diesem Schreiben möchten wir Sie, unseren Kunden, darüber informieren, welche der in Proposition 65 aufgeführten Stoffe in einer von der Schweizer Electronic AG hergestellten Leiterplatte enthalten sein können.

Die Proposition 65 Liste (Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986) wurde ursprünglich erstellt, um Kaliforniens Trinkwasser vor schädlichen Einflüssen durch bestimmte Chemikalien zu schützen. Sie ist in der Europäischen Union nicht verbindlich, hat jedoch Auswirkungen auf die Lieferketten in das nicht europäische Ausland. In der Proposition 65 Liste sind Chemikalien aufgeführt, welche als krebserregend oder fortpflanzungsgefährdend bekannt sind.

Ist ein Stoff aus der Liste in einem Produkt eines Herstellers enthalten und stellt der Umgang eines Verbrauchers mit diesem Produkt eine Gefahr dar, so muss der Verbraucher gewarnt werden. Diese Liste stellt keine Verbotsliste dar.

Stoffe, welche in der Proposition 65 gelistet sind und nach unserem jetzigen Kenntnisstand in unseren Leiterplatten enthalten sein können, sind in der umseitigen Tabelle aufgeführt.

Schweizer Electronic AG geht davon aus, dass, bei bestimmungsgemäßen Umgang, keinerlei Gefahr für die Gesundheit von ihren Leiterplatten ausgeht.

Mit freundlichen Grüßen  
SCHWEIZER ELECTRONIC AG

Dear Sir or Madam,

With this letter we would like to inform you, our customer, which of the substances listed in Proposition 65 may be contained in a printed circuit board manufactured by Schweizer Electronic AG.

The Proposition 65 list (Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986) was originally created to protect California's drinking water from harmful effects of certain chemicals. It is not binding in the European Union, but has an impact on supply chains to non-European countries. The Proposition 65 list contains chemicals that are known to be carcinogenic or toxic to reproduction.

If a substance from the list is contained in a manufacturer's product and the handling of this product by a consumer poses a risk, the consumer must be warned. This list is not a list of prohibited substances.

Substances which are listed in Proposition 65 and which, to the best of our current knowledge, may be contained in our printed circuit boards are listed in the table overleaf.

Schweizer Electronic AG assumes that, when used as intended, its printed circuit boards pose no risk to health.

Kind regards,  
SCHWEIZER ELECTRONIC AG

Name	CAS	In Matrix	Anmerkung / Remark
Trimethylolpropane; 2-ethyl-2-[[[(1-oxoallyl)oxy]methyl]-1,3- propanediyl diacrylate	15625-89-5	L	Nach Aushärten nur noch in Spuren / After hardening, only traces left
Carbon Black	1333-86-4	L; Paste	Nach Aushärten nur noch in Spuren / After hardening, only traces left
Cumol / Cumene	98-82-8	L	Nach Aushärten nur noch in Spuren / After hardening, only traces left
Silizium / Silicium	Diverse Several	L; Paste; BM	Im Lack dispergiert, keine Pulver / dispersed in the lacquer, no powder Siliziumverbindungen im Glas / Silicon compounds in the glass
Naphthalen / e	91-20-3	L; Paste	Nach Aushärten nur noch in Spuren / After hardening, only traces left
Formaldehyd / e	50-00-0	Paste	Nach Aushärten nur noch in Spuren / After hardening, only traces left
Ethylbenzene	100-41-4	BM	Nach Aushärten nur noch in Spuren / After hardening, only traces left
Titandioxid / Titanium dioxide	1363-67-7	L	Im Lack dispergiert, keine Pulver / dispersed in the lacquer, no powder
Methanol	67-56-1	Paste; BM	Nach der Verarbeitung maximal in Spuren / after treatment only traces left
Blei / Lead	7469-92-1	BM; E	Begleitstoff Glas und Kupfer / accompanying substance of glass and copper Endoberfläche PbSn / surface finish PbSn
Nickel	7440-02-0	BM; E	Begleitstoff Kupfer, im Glas enthalten / accompanying substance of glass and copper Endoberfläche NiAu / surface finish NiAu
TBBA (Tetrabrombisphenol A)	79-94-7	BM	Reaktives TBBA, nach dem Verpressen maximal noch in Spuren / reactive TBBA, maximum traces after pressing
BPA (Bisphenol A)	80-05-7	BM; L	Nach dem verpressen maximal noch in Spuren / just traces after pressing
N,N-dimethylacetamid / e (DMAC)	127-19-5	BM	Nach dem verpressen maximal noch in Spuren / only traces left after pressing
Toluen / e	108-88-3	BM; L	Nach der Verarbeitung maximal in Spuren / after treatment only traces left
Berillium	7440-41-7	F	Begleitstoff Kupfer / accompanying substance of copper
Arsen / Arsenic	7440-38-2	F	Begleitstoff Kupfer in Spuren / accompanying substance of copper, only traces
N-Dimethylformamid / e	68-12-2	BM	Nach der Verarbeitung maximal in Spuren / after treatment only traces left
Kobalt / Cobalt	7440-48-4	E	Nur in Hartgold in geringen Konzentrationen / in hard gold surface only small amounts

L = Lack/Lacquer; BM = Basismaterial / Base Material; E = Endoberfläche / Surface finish; F = Kupferfolie, Inlay / Copper foil, Inlay